

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月開催
基準日	期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日
単元株式数	100株
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人 同事務取扱場所 (郵便物送付先)	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	☎0120-782-031
(インターネットホームページURL)	<a href="https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/">https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/</a>
公告の方法	当社のホームページに掲載する <a href="https://www.ferrotec.co.jp/">https://www.ferrotec.co.jp/</a>
上場証券取引所	株式会社東京証券取引所 スタンダード

・株主に関する住所変更等のお届出およびご照会について  
証券会社の口座をご利用の場合は、三井住友信託銀行ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。証券会社の口座のご利用がない株主様は、上記電話照会先までご連絡ください。

年間IRカレンダー

第4 四半期			第1 四半期			第2 四半期			第3 四半期		
1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
	第3四半期開示		本決算	決算発表 決算説明会	株主総会	第1四半期開示		中間決算		中間決算発表 中間決算説明会	



株式会社 フェローテック

〒103-0027  
東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル5階  
TEL 03-3281-8808 FAX 03-3281-8848  
URL <https://www.ferrotec.co.jp/>



見やすいユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。



森林に配慮して適切に管理された  
森林認証紙を使用しています。



環境に配慮した植物油インキを  
使用しています。

第46期  
中間決算報告

2025年4月1日～2025年9月30日  
証券コード：6890



株式会社 フェローテック

株主の皆様へ



代表取締役社長  
グループCEO  
賀 賢漢

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。ここに第46期中間決算報告をお届けするにあたりご挨拶申し上げます。

当社グループの事業環境は、半導体業界については米中半導体摩擦に伴う地政学的リスク対応に加え、米国政府による関税政策の影響の見極めが難しい状況が続きました。こうしたなか、当社は2022年以降、顧客企業の中国外調達(Ex-China)ニーズを充足するべく、マレーシアおよび日本での量産拠点づくりに努めてまいりました。特に「日本回帰」を標榜し工場建設を進めてきた石川第3工場(セラミックス)が本年7月に、熊本工場(半導体製造工場向けの精密部品再生洗浄)が10月に完成し、地元自治体様、顧客企業様ご列席のもと竣工式を執り行うことができました。また、マレーシア北部(クリム)での第2工場の建設も着手し、順調に工事を進めております。一方、中国の半導体市場の重要性もますます高まっていくことが予想されており、当社は中国製造拠点のブラッシュアップを行いながら、旺盛な中国需要を取り込んでまいります。

本中間決算は、各国で増強してきた生産能力を生かし前年を上回る売上高、営業利益を上げることができました。売上高については半期での過去最高を更新することができました。

中間配当金に関しては、新しい配当方針(株主資本配当率)に基づき、1株当たり74円とさせていただきます。

これら施策を進めてこれましたのも、ひとえに株主の皆様のご理解、ご支援の賜物であると感謝いたしております。

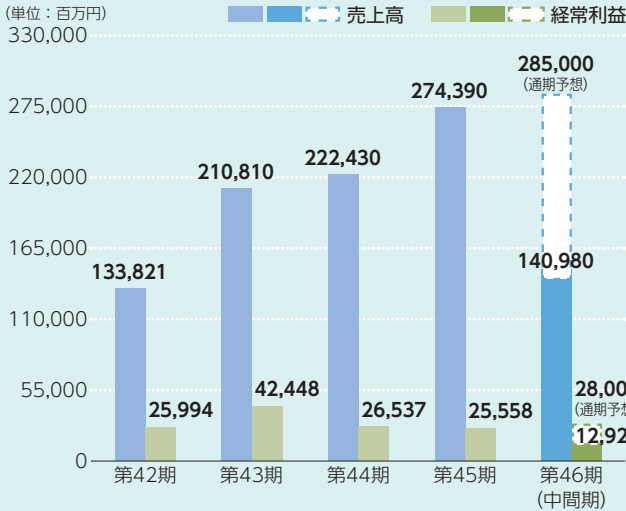
当社グループはこれからも事業成長を追求し、株主の皆様にとって「成長する楽しみが持てる企業」であり続けるよう努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

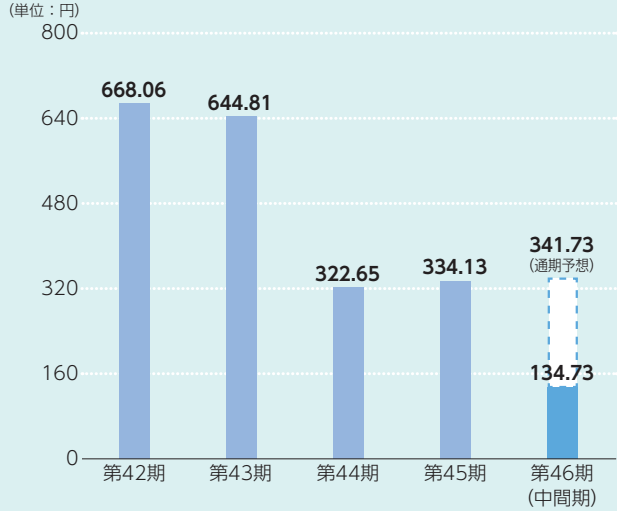
2025年12月吉日

財務ハイライト

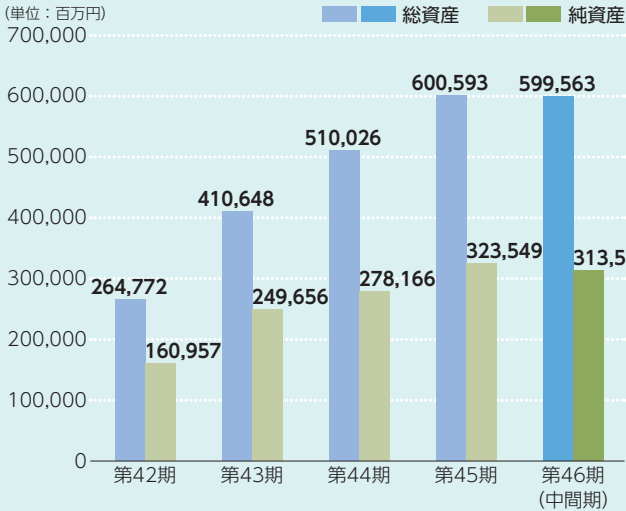
売上高／経常利益



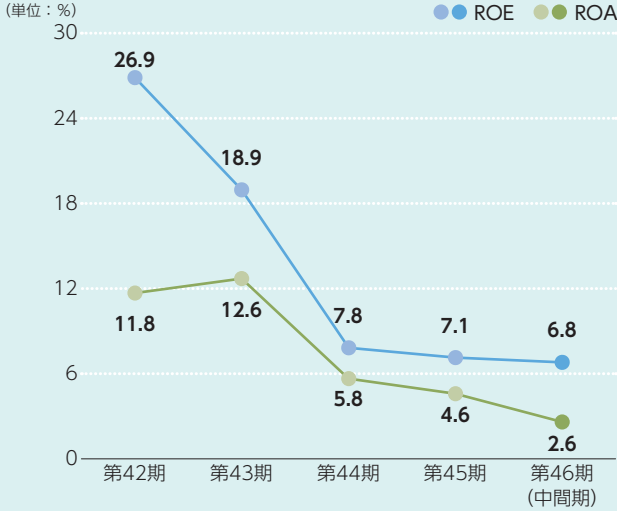
1株当たり当期(中間)純利益



総資産／純資産



ROE(自己資本当期純利益率)／ROA(総資産経常利益率)



※第46期については、通期業績予想数値をベースにしています。



# フェローテック 石川第3工場・FTSVJ 熊本工場稼働開始

## フェローテック

### 石川第3工場稼働でセラミックス部材の国内量産能力を強化

#### ● 石川県内に新たなセラミックス工場を設置

フェローテックの新たな量産拠点「石川第3工場」が25年7月に稼働を始めました。ここでは半導体製造装置向けセラミックス部材等の製造を手掛けます。セラミックスは半導体製造装置の部品や半導体のパッケージに不可欠な材料です。

石川工場は、セラミックスでありながら焼成後にも加工がしやすい特徴を持つ「マシナブルセラミックス」(商標名「ホトパール」)の生産拠点としてスタートしています。2022年には石川第2工場と開発センターを設置し、今回、石川第3工場を設置することで、石川はフェローテックにとって日本国内の一大生産集積地となります。

#### ● 地元北陸のみならず国内全域でセラミックス事業拡大

フェローテックは1992年以降、中国に量産拠点を設置しコスト競争力と供給能力を武器にグローバル展開し、事業拡大を図ってきました。その結果、2022年3月期時点で固定資産の設置場所の8割以上が中国となりました。そのようななかで米中半導体摩擦が勃発しました。

日本の製造拠点は、2022年時点で石川工場(第1、第2)、関西工場、岡山工場、千葉工場があったものの、中国の工場ほどの量産能力はなく、試作製造等も手掛ける比較的小規模な設備ばかりでした。石川第3新工場はビジネス環境の変化を受け、日本回帰戦略下での創設となります。石川県をはじめ北陸には半導体企業も多くあり、今後、開発センターとともに半導体メーカーへの問題解決にも取り組んでいきます。もちろん、北陸のみならず、日本国内でのセラミックス事業拡大を目指します。



石川にある3つの工場の中で最大規模を誇る「フェローテック 石川第3工場」

#### フェローテック 石川第3工場 概要

住 所	〒923-1253 石川県能美郡川北町字三反田200-1
工 場 面 積	建屋面積：13,000㎡、(敷地面積：30,000㎡)
主 要 設 備	焼成炉／熱処理炉／マシニングセンター／ 洗浄設備／三次元測定機、画像測定機 (クリーンルームクラス：10000／1000)
生 産 能 力	約100億円 (2028年：約140億円まで増強を想定)
従 業 員 数	116名(2028年：約200名を想定)

## 背景

### 中国以外での製造能力強化をねらい日本回帰

2018年に火蓋が切られた米中半導体摩擦は、2022年に更に激化し、市場における不透明感が高まっています。当グループは地政学的リスク回避のため量産拠点の大部分を中国に置く戦略を見直し、中国以外での製造能力の強化を急務としました。そこで拠点設置を進めたのがマレーシアと日本です。特に日本は、2024年に世界最大手のファウンドリであるTSMCが熊本に拠点を設置、2022年には国産ファウンドリのラピダス社創設などもあり、半導体製造拠点として製造能力が高まっています。これを大きな事業機会と捉え、日本市場の深耕をねらう日本回帰戦略の一環として2025年に国内の2工場を竣工させました。

## FTSVJ

### 半導体製造工場向け精密部品再生洗浄サービス、中国から日本に逆上陸

#### ● 強みは1桁ナノメートル単位の精密さと再生機能

フェローテックのグループ会社である、フェローテックテクノロジーデベロップメントジャパン (FTSVJ:熊本県菊池郡大津町)は、半導体製造工場向けの装置設備の精密部品再生洗浄サービス拠点として熊本工場を竣工しました。半導体製造工場向け精密部品再生洗浄サービスでは、半導体製造設備の着脱可能な部品、部材に付着した汚れの除去のみならず修理・再生までを手掛けます。

FTSVJは精密な対応が強みで、半導体製造の過程で行われる成膜、熱処理など様々な処理にも、製品種別(ロジック、メモリ等)によって異なる洗浄方法やプロセスにも最先端の1桁ナノメートル単位で対応が可能です。

また、各種部品・部材は製造環境がタフになるにつれて生じる部材のコーティング摩耗や破損に対応できるよう、製造設備の中にコーティング機能を備え、補修・再生ができる強みも有します。

#### ● 中国で実績ある洗浄技術を熊本から全国に発信

FTSVJの精密部品再生洗浄事業は、すでに中国において世界で有数の半導体装置メーカー、ファウンドリ等との取引実績があり、中国における半導体工場シェアは約60%に達します。半導体製造における1桁ナノメートルの最先端技術への対応力、大量洗浄処理できる設備とノウハウおよび幅広いお客様から得た経験値を生かし、日本上陸を機に日本のお客様のお役に立ちたいと考えています。

グループの総合力を活用し、熊本県下にとどまらず半導体企業様の問題解決を図り、精密部品再生洗浄を基盤とする付加サービスの強化で国内での事業拡大を目指します。



日本進出したTSMCと同県内に開設された「FTSVJ 熊本工場」

#### フェローテックテクノロジーデベロップメントジャパン 熊本工場 概要

住 所	〒869-1236 熊本県菊池郡大津町杉水字一の迫2985-1
工 場 面 積	建屋面積：7,300㎡、(敷地面積：30,000㎡)
主 要 設 備	PVD・CVD・エッチング装置部品再生洗浄設備／ プラズマ溶射機／アーク溶射機／ 超音波顕微鏡、三次元測定機 (クリーンルームクラス：100)
従 業 員 数	56名(2028年：約200名を想定)

## オープンラボ「サーマルソリューションCSセンター」開所

フェローテックは“熱”に関する多岐にわたる課題を解決する“トータルサーマルソリューション”をお客様に提供するオープンラボ『サーマルソリューションCSセンター（以下、オープンラボ）』を2025年11月に開所しました。

### ■ 検討工数の削減により、開発期間の短縮に貢献

お客様の製品にサーモモジュールを実装するにあたっては、様々な関連部品との組み合わせが考えられその選択肢は数万通りに及ぶこともあります。そのため個々の製品に応じた最適な組み合わせを選び出すには十分な検討が必要になってきます。

オープンラボでは、1980年代から蓄積してきた知見とデータを活かして、お客様の製品に求められる仕様を満たすサーモモジュールと関連部品の最適な組み合わせの提案とともに熱伝導のシミュレーション(サーマルシミュレーション)をします。その後続く試作・性能測定・信頼性評価試験や量産試作ももちろん手掛けていきます。

サーマルシミュレーションを計算に入れて開発の初期段階からサーモモジュールやアセンブリ等の製造をご確認いただきながら相談・検証を進められるオープンラボの開所によって、お客様の製品化の実現可能性を高めつつ検討工数を削減させ、開発期間

の更なる短縮に貢献してまいります。

オープンラボでは、それ以外にもサーモモジュールやチラー(恒温水循環装置)などの各種熱対策製品を展示・デモンストレーションができるほか、真空シール、磁性流体、半導体マテリアル製品(セラミックス、石英、CVD-SiC、シリコン)、センサーなどのフェローテック製品もご覧いただけるようになっています。



サーマルソリューションCSセンター 内観

#### フェローテック サーマルソリューションCSセンター 施設概要

**所在地** 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町1-1-32 アクアリアタワー横浜5階

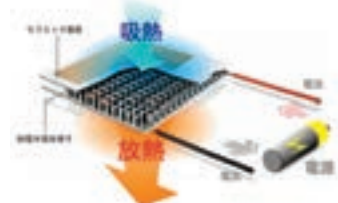
**主要設備** 恒温恒湿槽(200V×2、100V×2)、DT測定装置、走査型電子顕微鏡(SEM)、切断機、研磨機、3Dプリンター、組立作業設備、他

**展示製品** サーモモジュール(ペルチェ)各種、クーリングプレート・ホットプレート、各種チラー、各種応用製品、真空シール、磁性流体、半導体マテリアル製品(セラミックス、石英、CVD-SiC、シリコン)、センサー(大泉製作所)

#### サーモモジュール(ペルチェ素子)とは

コンパクトなヒートポンプの機能を有するサーモモジュールに電流を流すと、表側の面からもう一方の裏側へと熱が移動します(図)。この時に、サーモモジュールの表面は吸熱して冷却され、反対の面は加熱されます。また、直流電源の極性を入れ替えると、この現象が逆転し、逆方向に熱の移動が発生します。

このようにサーモモジュールは冷却および加熱のいずれの目的にも使用でき、センサーや制御器と合わせて使用することで、精密な温度調節が可能となります。



(図)サーモモジュールの熱移動

## 中国事業の動向(上場関連)

当社は子会社や製造拠点の多くを中国に保有しております。そのなかで特に上場(もしくは上場を目指す)子会社について、この半年の間に動きがございましたので進捗をご報告いたします。

### FTSVAがFLHの子会社化を完了

2025年7月25日、中国上場子会社(部品洗浄)である安徽富楽徳科技発展股份有限公司(以下、「FTSVA」)は、パワー半導体用絶縁放熱基板製造子会社である江蘇富楽華半導体科技股份有限公司(以下、「FLH」)の資産取得のための株式及び転換社債の発行を実施し、子会社化を完了しました。また、2025年9月4日には、パワー半導体用基板開発等を目的とした約7.8億元(約161億円)の第三者割当増資も実施しました。

上場市場	深セン証券取引所創業板
証券略称	富乐徳
証券番号	301297

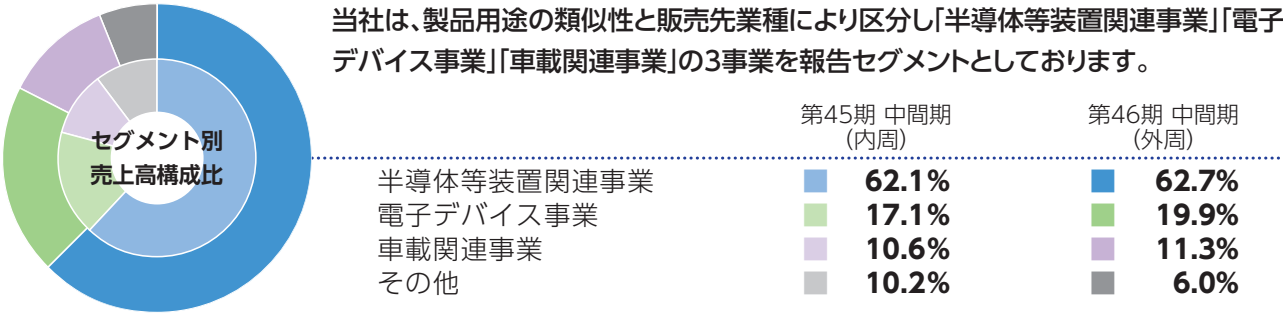
### CCMCが新三板(中国店頭取引市場)へ登録

当社の半導体ウエーハ事業を行う 持分法適用会社である杭州中欣晶圆半導体股份有限公司(以下、「CCMC」)が、中国の店頭取引市場である中国新三板(全国中小企業株式譲渡システム、以下「新三板」)で株式の店頭登録を承認され、2025年10月22日より店頭取引可能となりました。また登録と同時に新三板を通じて、固定資産購入や有利子負債返済等を目的とする6.1億元(約129億円)の第三者割当増資も実施しました。今後、麗水第2工場の段階的な製造能力の増強を行いながら、従来拠点(杭州、上海、銀川)製造設備のブラッシュアップを行い、品質の更なる向上、自動化・省人化の推進等を進めてまいります。

証券略称	中欣晶圆
証券番号	874810



セグメント別事業概況



半導体等装置関連事業 売上高 883億円 営業利益 81億円

生成AI関連の投資が旺盛ながら、米中半導体摩擦や米国関税政策が下押しをしている状況である一方、中国国内の半導体需要は政府の支援が継続され相対的に堅調です。このような事業環境のなか、真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品は、米国メーカー、中国メーカーの堅調な需要を受け増収となりました。半導体マテリアル製品では、セラミックスが大きく売上を伸ばし、石英やCVD-SiCも増加しました。部品洗浄サービスは、中国の半導体及びFPD工場の良好な稼働率を背景に増収となりました。一方、石英坩堝は太陽光パネル需要の調整により減収となりました。また、減価償却費をはじめとする新工場の立上げ費用負担増も利益に影響を与えております。

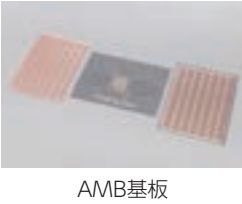
電子デバイス事業 売上高 280億円 営業利益 58億円

サーモモジュールは、好調な生成AIサーバー投資を背景に光トランシーバー向け出荷が伸びました。パワー半導体用基板も順調に売上を伸ばしています。センサの収益は前年度の株式会社大泉製作所の決算期変更の影響で第1四半期の収益計上がなかったのに対し、今期は収益計上しているため純増となっております。

車載関連事業 売上高 159億円 営業利益 14億円

パワー半導体用基板は、AMB基板の販売が増加しましたがDCB基板の販売がやや減少し、全体では小幅な伸びにとどまりました。サーモモジュールは、EV市場の変化を受け売上が減少しました。センサは電子デバイス事業同様、前年度の株式会社大泉製作所の決算期変更の影響で今期第1四半期分の収益が純増となっております。

※ 記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。また、各セグメントの売上高は、外部顧客に対する数値を記載しております。



連結財務諸表（要約）

決算情報についての最新情報、詳細につきましては当社のIRサイトをご覧ください。  
<https://www.ferrotec.co.jp/ir/>



連結貸借対照表 (単位:百万円)		
科 目	当中間期 2025年9月30日現在	前期 2025年3月31日現在
資産の部		
流動資産	296,468	295,367
固定資産	303,095	305,226
有形固定資産	242,351	245,064
無形固定資産	5,496	6,166
投資その他の資産	55,247	53,996
資産合計	599,563	600,593
負債の部		
流動負債	150,376	151,750
固定負債	135,616	125,292
負債合計	285,993	277,043
純資産の部		
株主資本	191,195	188,595
その他の包括利益累計額	30,536	48,235
新株予約権	977	—
非支配株主持分	90,860	86,718
純資産合計	313,570	323,549
負債純資産合計	599,563	600,593

連結キャッシュ・フロー計算書 (単位:百万円)		
科 目	当中間期 2025年4月 1 日から 2025年9月30日まで	前中間期 2024年4月 1 日から 2024年9月30日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,405	4,151
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,596	△17,736
財務活動によるキャッシュ・フロー	25,061	12,169
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5,467	8,978
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△596	7,562
現金及び現金同等物の期首残高	108,899	96,806
現金及び現金同等物の中間期末残高	108,302	104,368

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書 (単位:百万円)		
科 目	当中間期 2025年4月 1 日から 2025年9月30日まで	前中間期 2024年4月 1 日から 2024年9月30日まで
売上高	140,980	135,157
売上原価	100,200	97,046
売上総利益	40,780	38,111
販売費及び一般管理費	26,446	23,859
営業利益	14,333	14,251
営業外収益	4,010	5,324
営業外費用	5,420	4,105
経常利益	12,923	15,470
特別利益	—	5
特別損失	493	—
税金等調整前中間純利益	12,430	15,475
法人税等	4,226	4,056
中間純利益	8,203	11,418
非支配株主に帰属する中間純利益	1,895	2,228
親会社株主に帰属する中間純利益	6,308	9,190

連結包括利益計算書 (単位:百万円)		
科 目	当中間期 2025年4月 1 日から 2025年9月30日まで	前中間期 2024年4月 1 日から 2024年9月30日まで
中間純利益	8,203	11,418
その他の包括利益	△23,181	34,438
その他有価証券評価差額金	445	△894
為替換算調整勘定	△21,330	31,642
退職給付に係る調整額	△116	80
持分法適用会社に対する持分相当額	△2,179	3,610
中間包括利益	△14,978	45,857
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	△11,390	35,820
非支配株主に係る中間包括利益	△3,588	10,037

株式情報／会社情報 (2025年9月30日現在)

株式の状況

発行可能株式総数	100,000,000株
発行済株式総数	47,117,949株
株主数	37,063名

大株主

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
MSIP CLIENT SECURITIES	2,307,699	4.92
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223	1,405,130	2.99
JPモルガン証券株式会社	1,278,875	2.73
山村 清子	856,200	1.82
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	844,800	1.80
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD	803,156	1.71
JP MORGAN CHASE BANK 385632	743,501	1.58
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	698,800	1.49
UBS AG LONDON A/C IPB SEGREGATED CLIENT ACCOUNT	623,831	1.33
JP MORGAN CHASE BANK 385781	600,600	1.28

(注) 1.当社は、自己株式279,602株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。  
2.表示単位未満を切り捨てて表示しております。

所有者別株式分布状況

